**職務工作說明書**

職務編號： 職位分析日期： 113 年 01 月 19 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部門 | 新品設計部 | 職稱 | 機構研發工程師 |
| 直接上級 | 新品設計部主管 | 直接下級 |  |
| 教育水平 | 大學以上(含在學中) | 語言程度 | 國、英語 |
| 科系 | 化工/機械/材料工程相關學歷 | 具備專業 | 水路氣路設計組裝 |
| 相關經驗 | 需熟悉繪圖及能焊接組裝 | 證照需求 | 無 |
| 適合之人格特質 | 外向、勤奮 |
| 使用工具或設備 | 其它手工具 |
| 工作地點/環境 | 竹北/湖口實驗室 |
| 工作時間 | 08:30~17:30(暑假前需能每周配合至少三天上班，暑假期間工作日為每周一至五) |
| 薪資待遇 | 時薪250元 |
| 內部協調關係 | 與公司內部各單位整合溝通及本單位工作整合協調 |
| 外部協調關係 | 與公司外部供應商整合溝通及協調 |
| **職務內容** | 日常工作項目1. 零組件設計製圖（熟AutoCAD及3D 繪圖軟體）
2. 管路P＆ID繪製（氣跟水路）及組裝
3. 研發專案材料BOM表建立
4. 研發專案實驗數據及條件測試
5. 組裝及測試

5. 主管其他交辦事宜 需定期產出之成果或完成之事項研發週報及實驗數據整理 |

**職務須具備重要之能力**

|  |  |
| --- | --- |
| 素質與能力要素 | 崗位勝任能力要求 |
| 低 | 中 | 中高 | 高 |
| 溝通表達/規劃能力 | 溝通協調 |  |  | ˇ |  |
| 邏輯分析 |  |  | ˇ |  |
| 抗壓性 |  |  | ˇ |  |
| 學習能力 |  |  | ˇ |  |
|  |  |  |  |  |
| 必備知識 | 基礎知識 | 零組件機構設計 |  |  | ˇ |  |
| 管路組裝能力如法蘭、VCR等組裝 |  |  | ˇ |  |
|  |  |  |  |  |
| 職務相關專業知識 | 真空管路P＆ID layout |  |  | ˇ |  |
| 熟悉設備電磁閥件及馬達等規格 |  |  | ˇ |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他知識 | 熟半導體廠subfab設備配置或客服經驗（有更佳但非必要） |  |  | ˇ |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 工作技能與其他綜合能力(如軟體/硬體/系統的設計、使用或維護能力) |  |  |  |  |  |
| 需有工程視圖能力 |  |  | ˇ |  |
| 設備機構設計 （solid word等軟體） |  |  | ˇ |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 簽核 | 總經理 | 人力資源部 | 單位主管 | 填表人 |
| 處級主管 | 部級主管 |
|  |  |  |  |  |
| 受理日期 |  |  |  |  |  |